

1. Попередньо сформована композиція в профільованій формі, яка містить:
 - (1) полімерну суміш, що містить:
 - а) щонайменше один полісульфідний компонент та
 - б) щонайменше один компонент на основі простого полііоєфіру, і
 - (2) суміш добавок, що містить по суті рівну кількість слюди та поліаміду.
2. Попередньо сформована композиція за п. 1, де співвідношення $a : b$ у полімерній суміші знаходиться в діапазоні від 10 : 90 до 90 : 10.
3. Попередньо сформована композиція за п. 2, де співвідношення $a : b$ у полімерній суміші становить 50 : 50.
4. Попередньо сформована композиція за п. 1, яка додатково містить отверджувач для полімерної суміші.
5. Попередньо сформована композиція за п. 4, де отверджувач містить окисник.
6. Попередньо сформована композиція за п. 5, де отверджувач містить діоксид марганцю.
7. Попередньо сформована композиція за п. 4, де отверджувач є реакційноздатним при температурі в діапазоні від 10 °C до 80 °C.
8. Попередньо сформована композиція за п. 1, де полімерна суміш присутня у кількості в діапазоні від 20 масових процентів до 30 масових процентів в розрахунку на сукупну масу попередньо сформованої композиції.
9. Попередньо сформована композиція за п. 4, де отверджувач є присутнім у кількості в діапазоні від 5 масових процентів до 20 масових процентів в розрахунку на сукупну масу попередньо сформованої композиції.
10. Попередньо сформована композиція за п. 1, яку попередньо отверджують при температурі в діапазоні від 10 °C до 30 °C.
11. Попередньо сформована композиція за п. 1, яка додатково містить одну чи кілька добавок, вибраних з наповнювачів, підсилювачів адгезії, розчинників, пластифікаторів, пігментів, тиксотропних добавок, уповільнювачів, каталізаторів і маскувальних добавок.
12. Попередньо сформована композиція за п. 1, яка додатково містить пластифікатор.
13. Спосіб закладання апертури, який включає:
 - а) покриття апертури попередньо сформованою композицією за п. 1; і
 - б) отвердіння композиції таким чином, щоб закрити апертуру.
14. Спосіб за п. 13, в якому поверхня, яка визначає апертуру, є поверхнею панелі, що видаляють.
15. Спосіб за п. 13, в якому апертура є простором між поверхнею, що примикає до отвору, і поверхнею панелі, що видаляють.
16. Спосіб за п. 13, в якому апертура знаходиться на повітряному судні.
17. Спосіб за п. 13, в якому перед нанесенням попередньо сформованої композиції щонайменше на одну поверхню, що визначає апертуру, наносять підсилювач адгезії.
18. Спосіб за п. 13, в якому перед нанесенням попередньо сформованої композиції щонайменше на одну поверхню, що визначає апертуру, наносять антиадгезійний засіб.
19. Електропровідна попередньо сформована композиція в профільованій формі, яка містить:
 - а) полімерну суміш, що містить:
 - i) щонайменше один полісульфідний компонент,
 - ii) щонайменше один компонент на основі простого полііоєфіру;
 - б) щонайменше один електропровідний наповнювач; і
 - с) суміш добавок, що містить по суті рівну кількість слюди та поліаміду.
20. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 19, де електропровідний наповнювач присутній у кількості в діапазоні від 2 масових процентів до 50 масових процентів в розрахунку на сукупну масу електропровідної попередньо сформованої композиції.
21. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 19, де наповнювач вибраний із вуглецю, графіту, металу та провідного полімеру.

22. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 19, де електропровідний наповнювач включає щонайменше вуглецеве волокно та/або технічний вуглець.
23. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 19, яка додатково містить щонайменше один інгібітор корозії.
24. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 19, яка додатково містить отверджувач для полімерної суміші.
25. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 24, де отверджувач містить окисник.
26. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 25, де отверджувач містить діоксид марганцю.
27. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 24, де отверджувач є реакційноздатним при температурі в діапазоні від 10 °C до 80 °C.
28. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 24, де отверджувач є присутнім у кількості в діапазоні від 5 масових процентів до 20 масових процентів в розрахунку на сукупну масу електропровідної попередньо сформованої композиції.
29. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 19, де електропровідна попередньо сформована композиція є отверджуваною при температурі в діапазоні від 10 °C до 30 °C.
30. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 19, де полімерна суміш присутня у кількості в діапазоні від 20 масових процентів до 50 масових процентів в розрахунку на сукупну масу електропровідної попередньо сформованої композиції.
31. Електропровідна попередньо сформована композиція за п. 19, яка додатково містить пластифікатор.
32. Спосіб закладання та/або екранування апертури, який включає:
 - а) покриття апертури попередньо сформованою композицією за п. 19; і
 - б) отвердіння композиції таким чином, щоб закрити апертуру та/або забезпечити екранування.
33. Спосіб за п. 32, в якому поверхня, яка визначає апертуру, є поверхнею панелі, що видаляють.
34. Спосіб за п. 33, в якому поверхня є поверхнею, що примикає до отвору.
35. Спосіб за п. 32, в якому апертура є простором між поверхнею, що примикає до отвору, і поверхнею панелі, що видаляють.
36. Спосіб за п. 32, в якому апертура знаходиться на авіаційному або аерокосмічному літальному апараті.
37. Спосіб за п. 32, в якому перед нанесенням електропровідної попередньо сформованої композиції щонайменше на одну поверхню, що визначає апертуру, наносять підсилювач адгезії.
38. Спосіб за п. 32, в якому перед нанесенням електропровідної попередньо сформованої композиції щонайменше на одну поверхню, що визначає апертуру, наносять антиадгезійний засіб.